

2019年3月期 決算説明会



サンケン電気株式会社

2019年5月8日

第1部 業績説明

- 18年度 通期業績
- 19年度 通期業績予想

第2部 成長戦略

- 市場別成長戦略

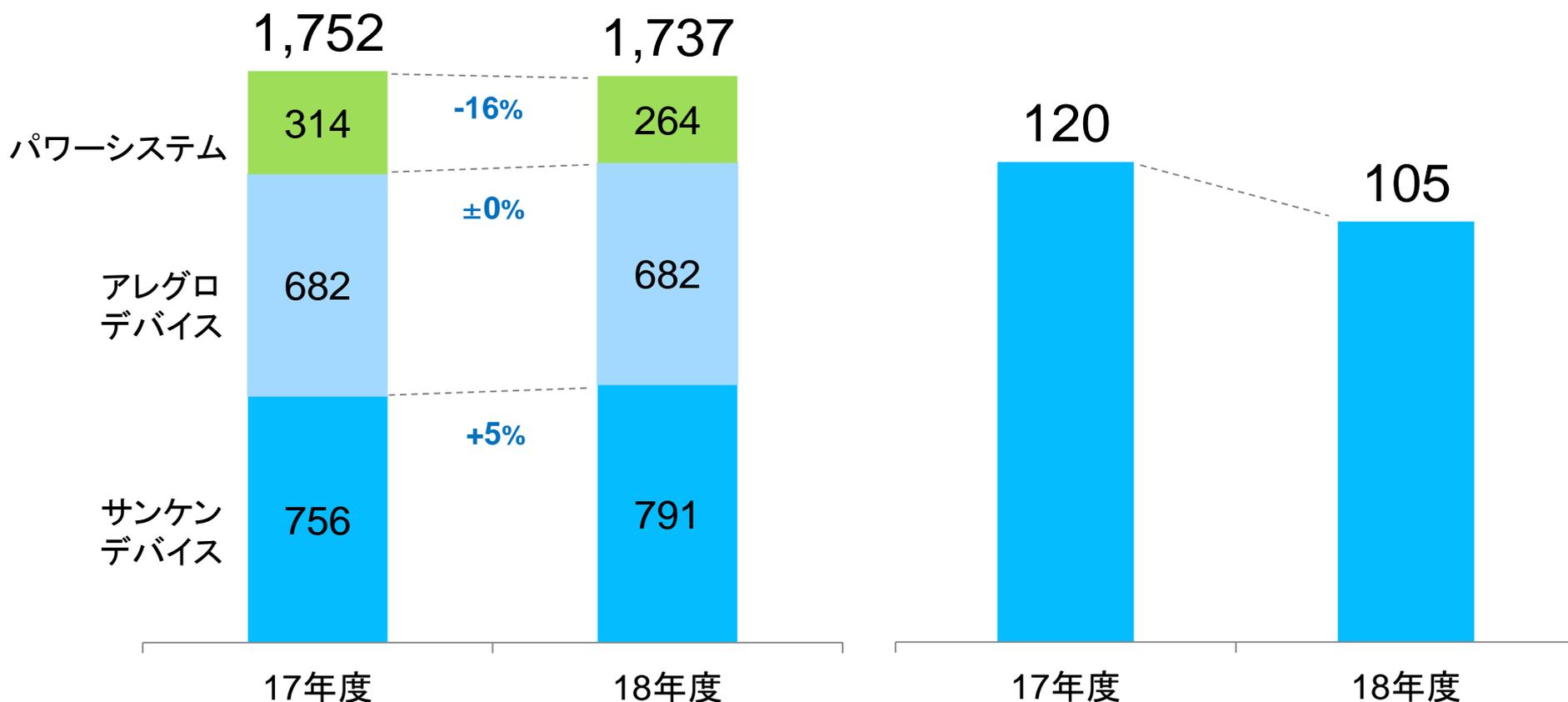
通期業績

2018年度 通期 連結業績 サマリー

上期は好調に推移したものの、3Q後半よりアレグロの車載を中心に減速し、通期では減益

■ 売上 (億円)

■ 営業利益 (億円)



・為替レート(通期): 17年度 110.86円/US\$ 18年度 110.93円/US\$

2018年度 通期 連結業績

(億円)

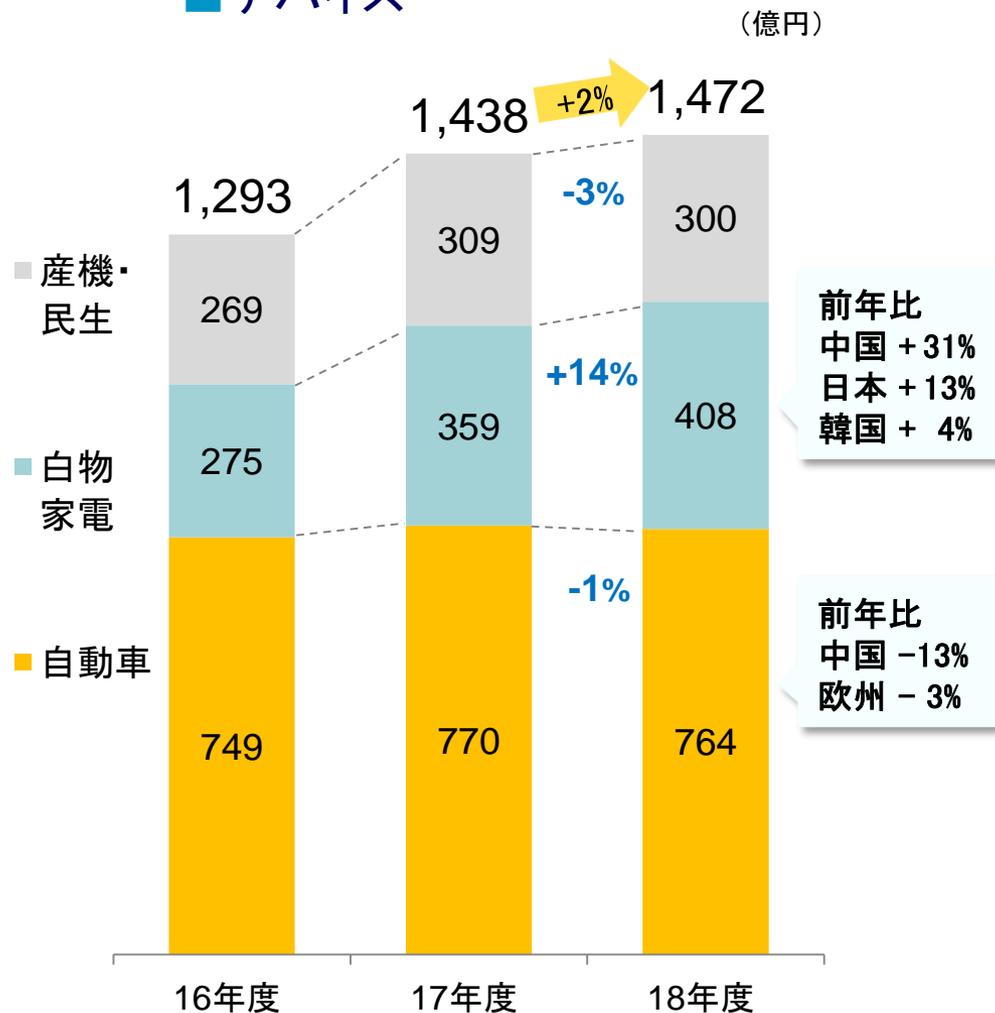
	17年度	18年度			前年 同期比 (%)	18年5月 公表値	達成率 (%)
	通期	上期	下期	通期			
売上高	1,752	882	855	1,737	-0.9	1,780	97.6
デバイス	1,438	752	720	1,472	+2.4	1,518	97.0
パワーシステム	314	130	134	264	-15.9	262	100.8
営業利益	120	63	42	105	-12.5	125	84.0
経常利益	118	53	39	92	-22.0	110	83.6
特別損益	-183	0	1	1	—	—	—
当期純利益	-114	22	18	40	—	48	83.3

為替レート: 17年度 110.86円/US\$ 18年度 110.93円/US\$

前期比率は本表に示した億円単位の数値から算出

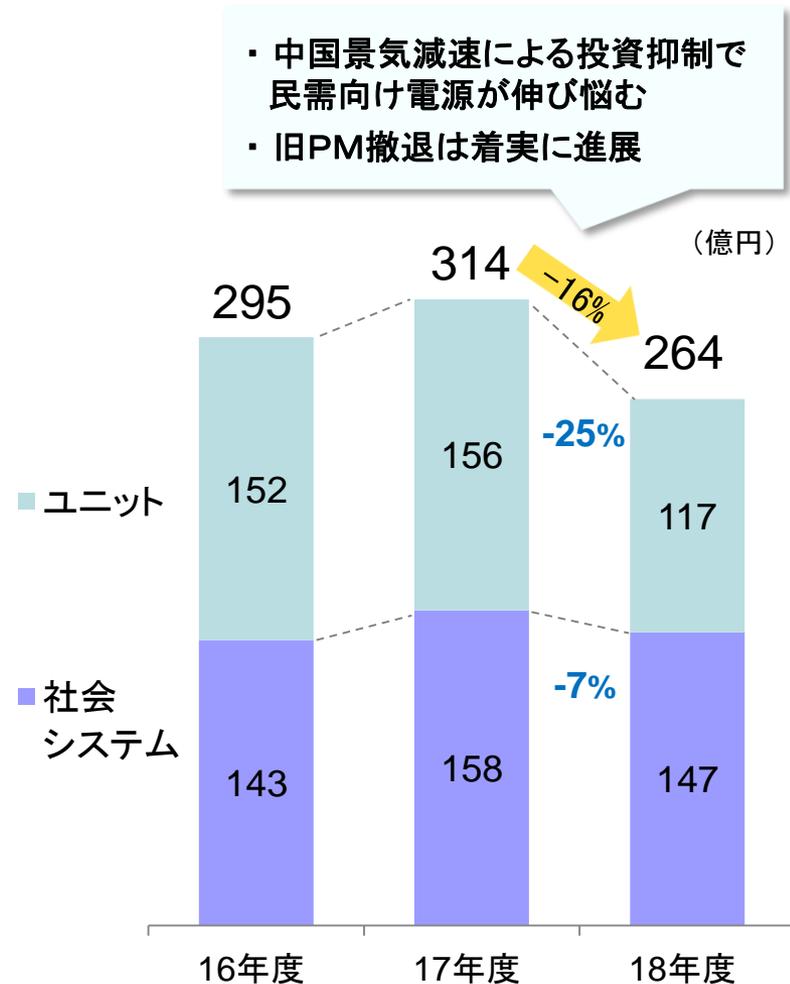
市場別 通期連結売上高推移

■ デバイス



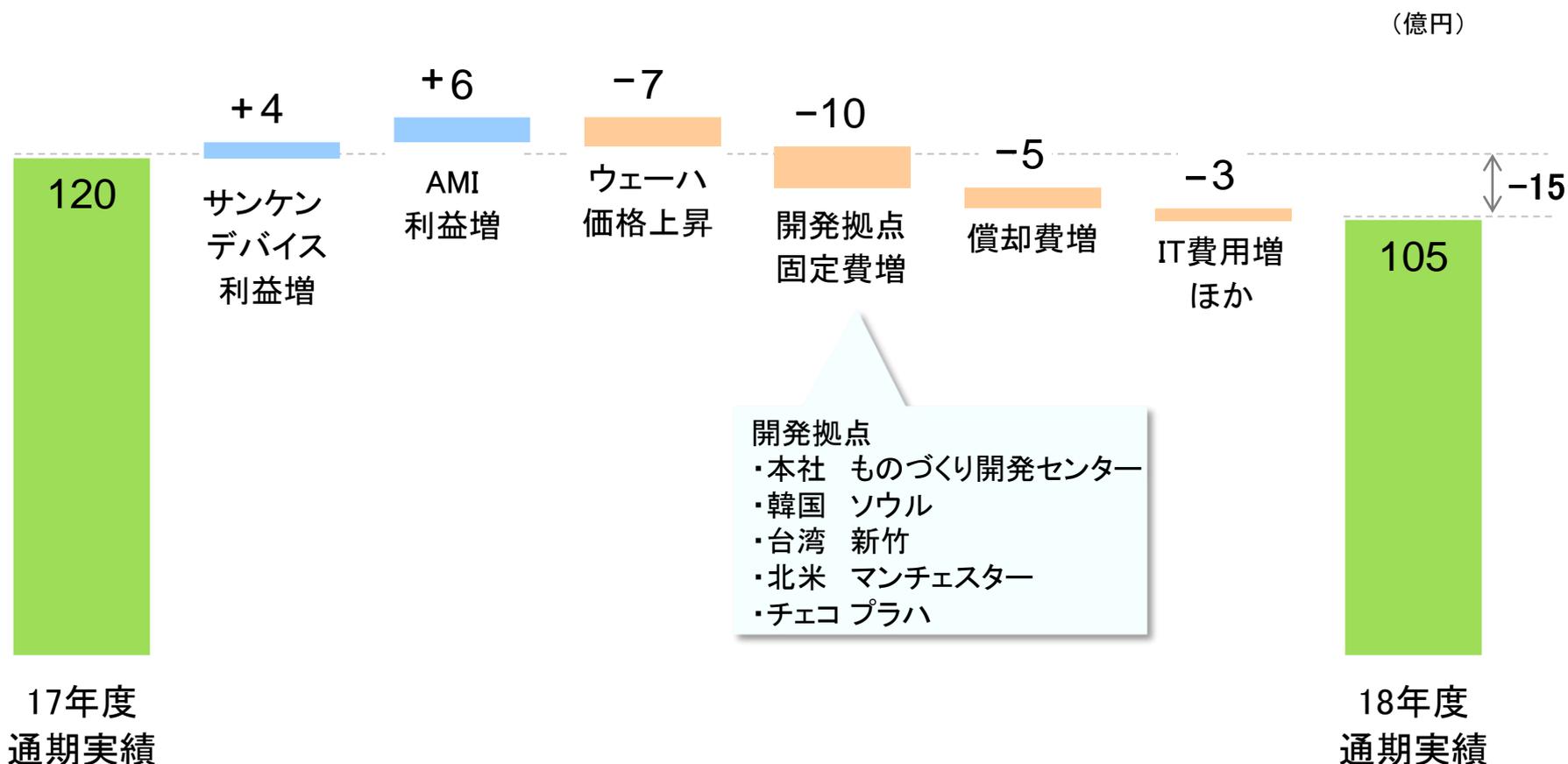
為替レート (/US\$) 108.39円 110.86円 110.93円

■ パワーシステム



2018年度 営業利益 前期比較

- 3Qよりアレグロの車載向けを中心に売上が減速
- ウェーハ価格上昇、開発拠点固定費増などを吸収できず減益



※AMI: アレグロ マイクロシステムズ インク (アレグロ マイクロシステムズ LLC (AML)、ポーラー セミコンダクターLLC (PSL)を有する統括会社)

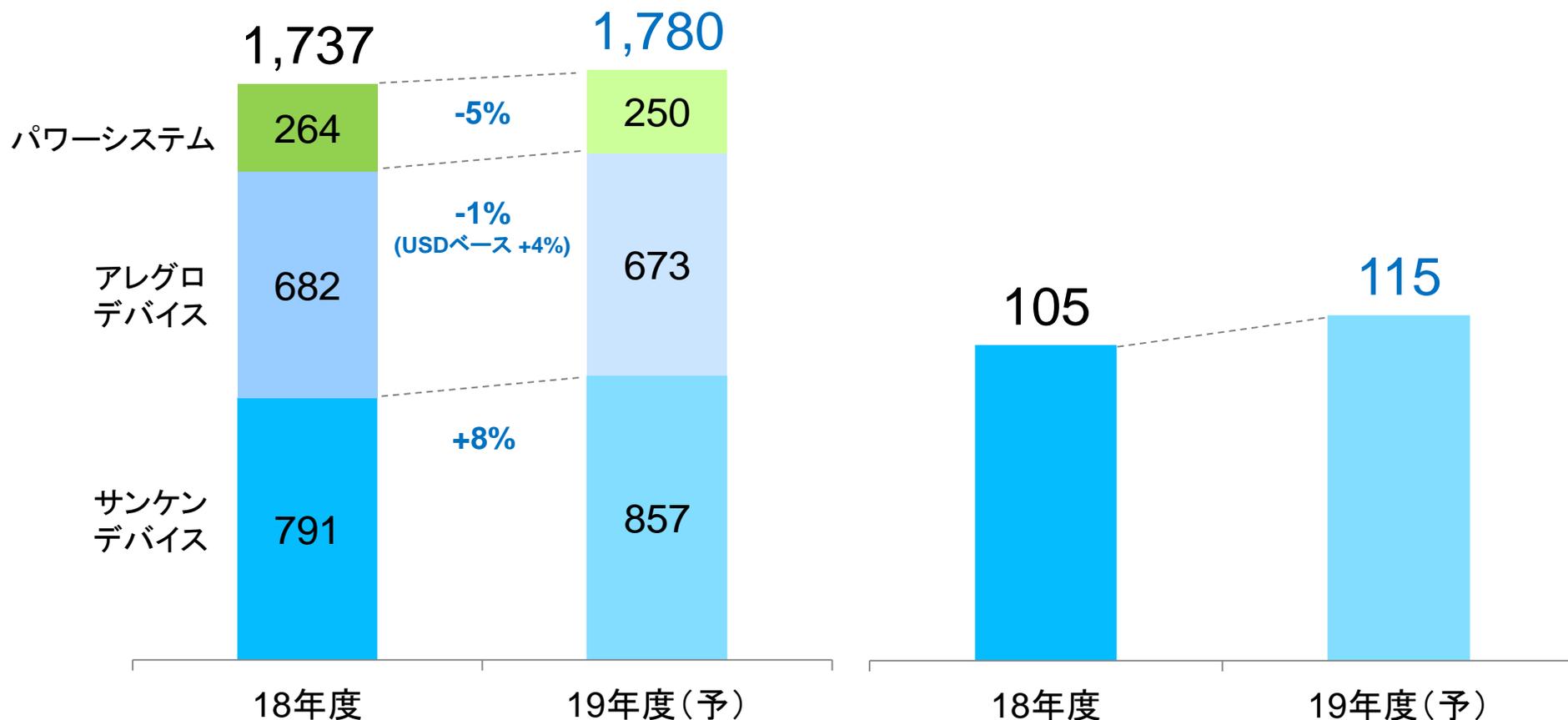
業績予想

2019年度 通期 連結業績予想サマリー

上期は中国景気減速の影響が残るものの、下期の需要回復を見込み
増収増益計画

■ 売上 (億円)

■ 営業利益 (億円)



・為替レート(通期): 18年度 110.93円/US\$ 19年度 105円/US\$

2019年度 通期 業績予想

(億円)

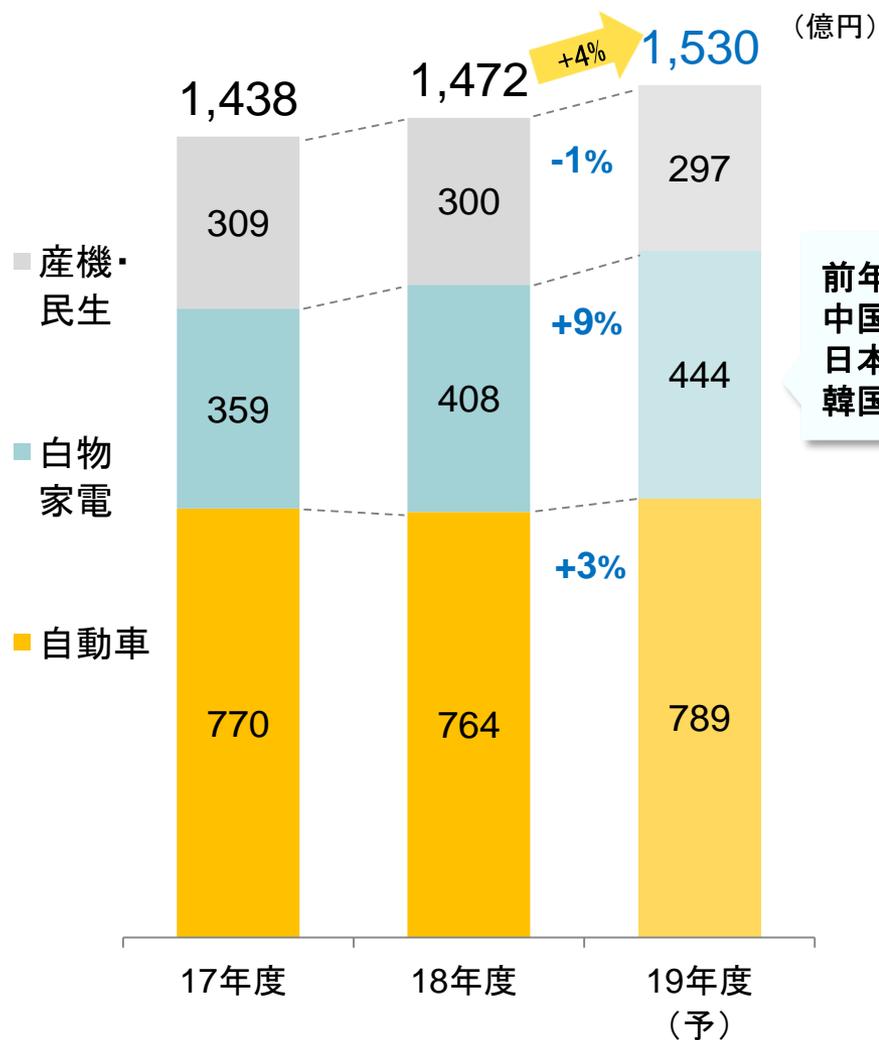
	18年度 実績			19年度 予想			前期比	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	金額	率 (%)
売上高	882	855	1,737	850	930	1,780	+43	+2.5
デバイス	752	720	1,472	736	794	1,530	+58	+3.9
パワーシステム	130	134	264	114	136	250	-14	-5.3
営業利益	63	42	105	35	80	115	+10	+9.5
経常利益	53	39	92	28	72	100	+8	+8.7
当期純利益	22	18	40	4	39	43	+3	+7.5

・ 為替レート： 105円/US\$

※ 前期比率は本表に示した億円単位の数値から算出

市場別 通期連結売上高 予想

■ デバイス



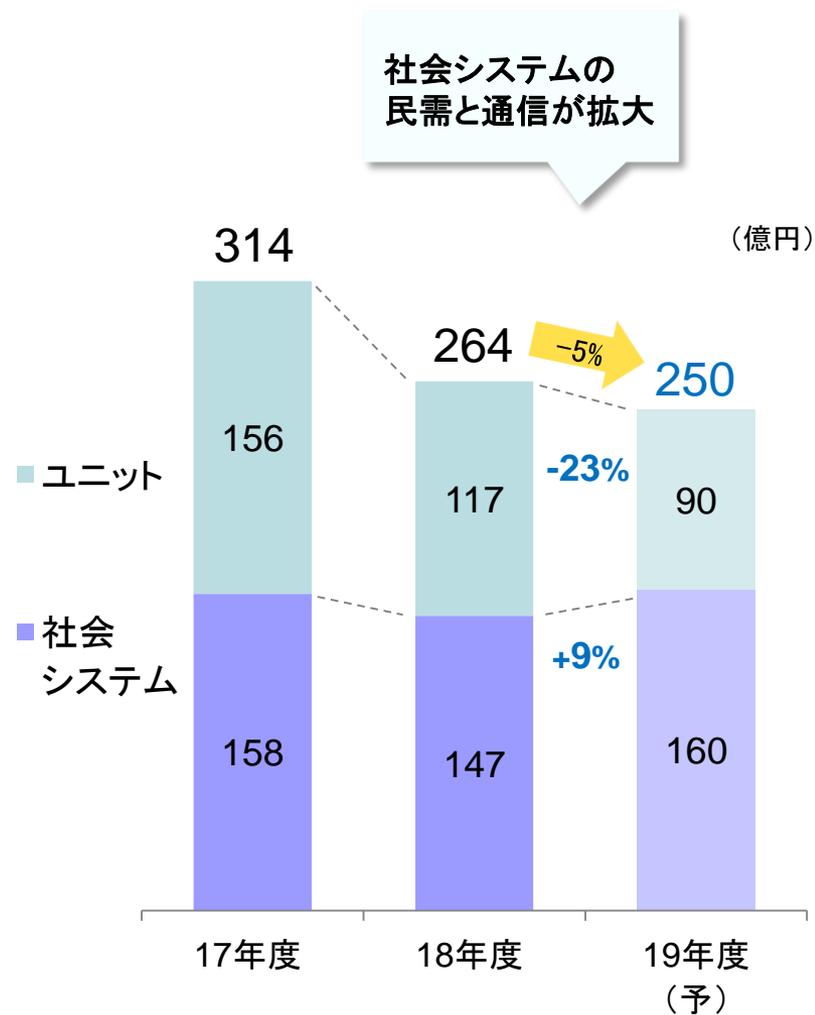
為替レート
(/US\$)

110.86円

110.93円

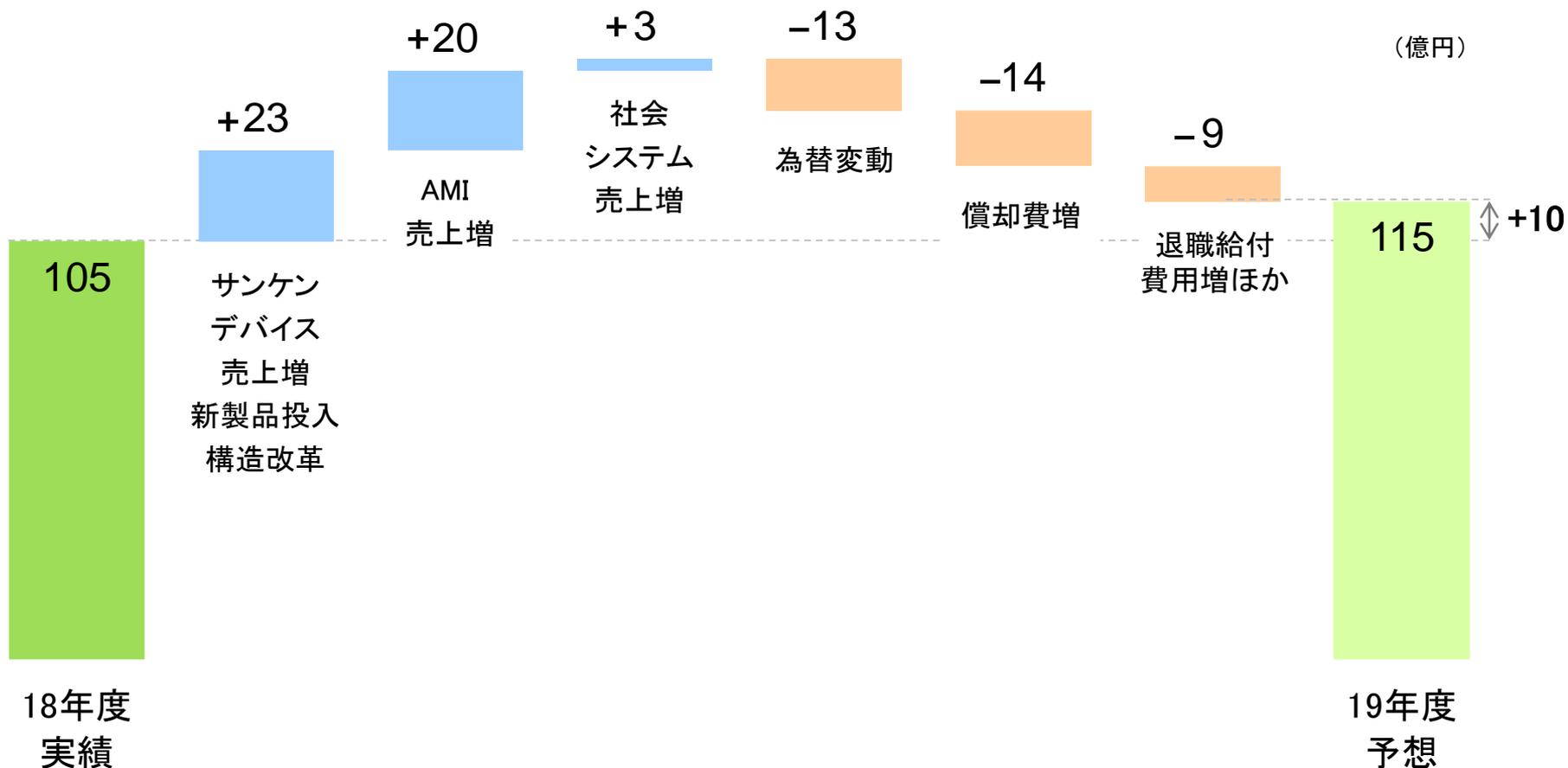
105.00円

■ パワーシステム



2019年度 営業利益 前期比較

- サンケン は売上増、新製品投入、不採算品対策などにより増益計画
- AMI は下期に車載の回復を見込む



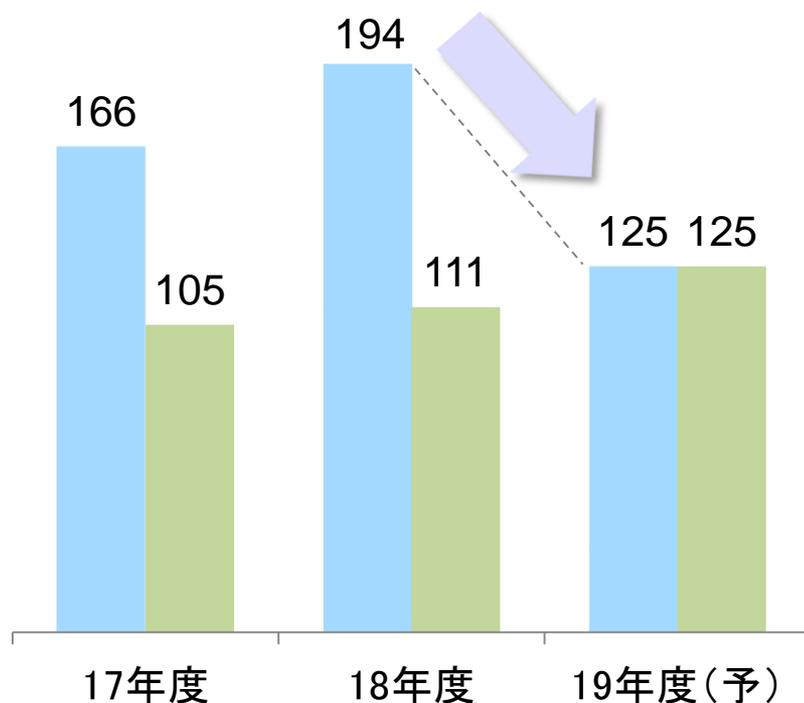
※AMI: アレグロ マイクロシステムズ インク

設備投資推移

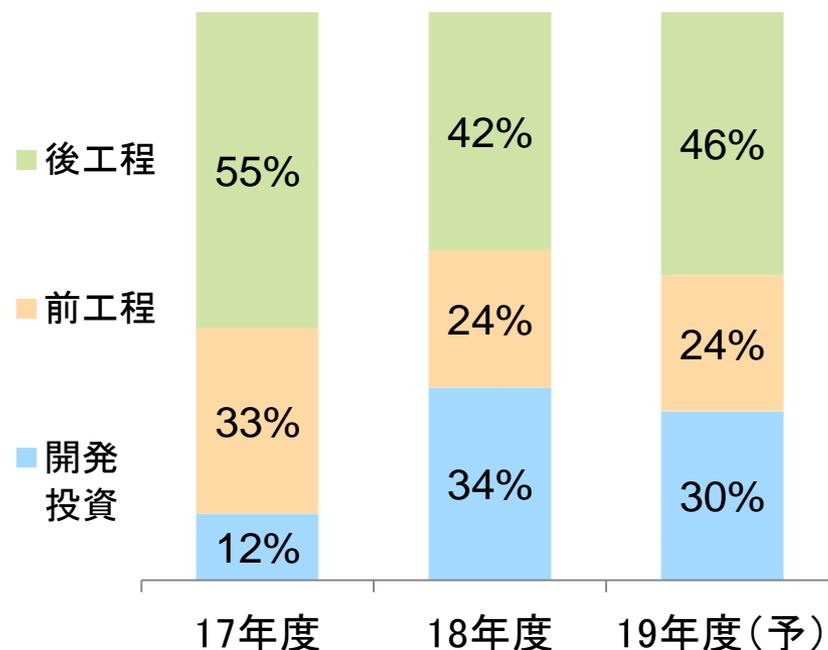
- 18年度：成長戦略実現に向けた多額の先行投資を実施
- 19年度：投資を大幅に抑制し、償却の範囲内にコントロールするが、開発投資は継続する

■ 設備投資・減価償却費 (億円)

■ 設備投資 ■ 減価償却費



■ デバイス投資比率



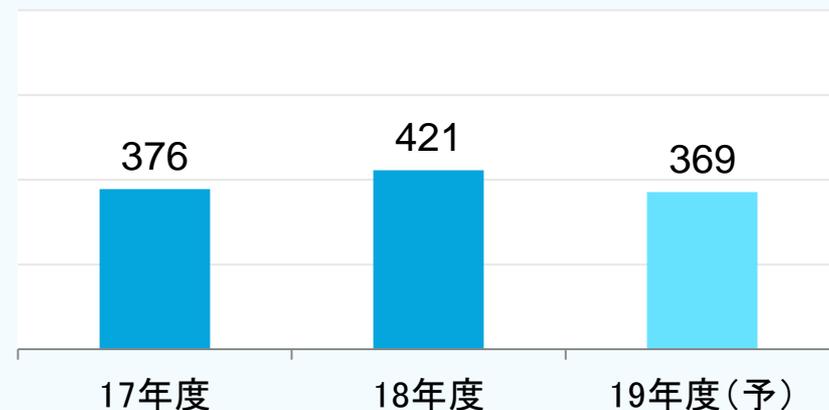
2019年度財務指標（連結）

設備投資・減価償却費 (億円)

■ 設備投資 ■ 減価償却費



在庫 (億円)



キャッシュフロー (億円)

■ 営業CF ■ 投資CF ◆ フリーCF



有利子負債 (億円)

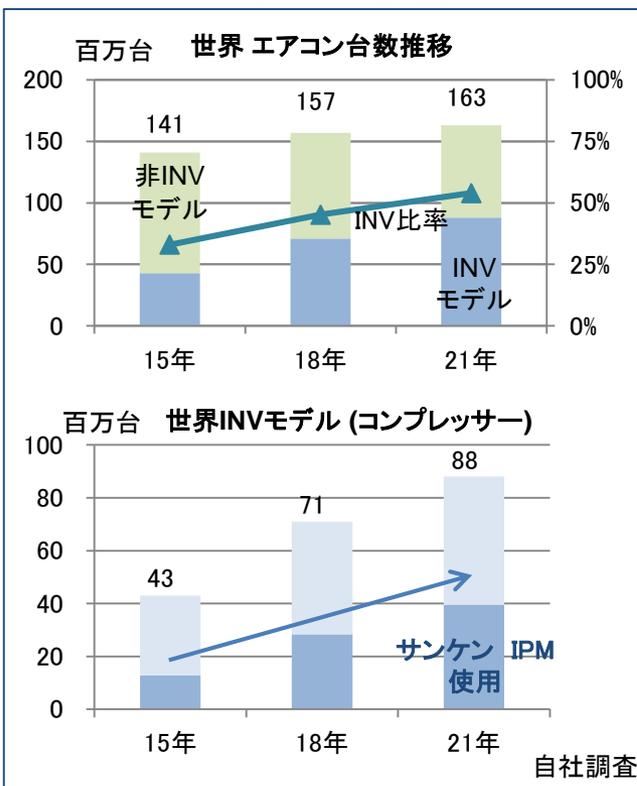


- ・ 在庫 : PSLチップの在庫調整を進め、18年3月末レベルへ削減
- ・ 設備投資 : 償却の範囲内にコントロールし、フリーCFを創出

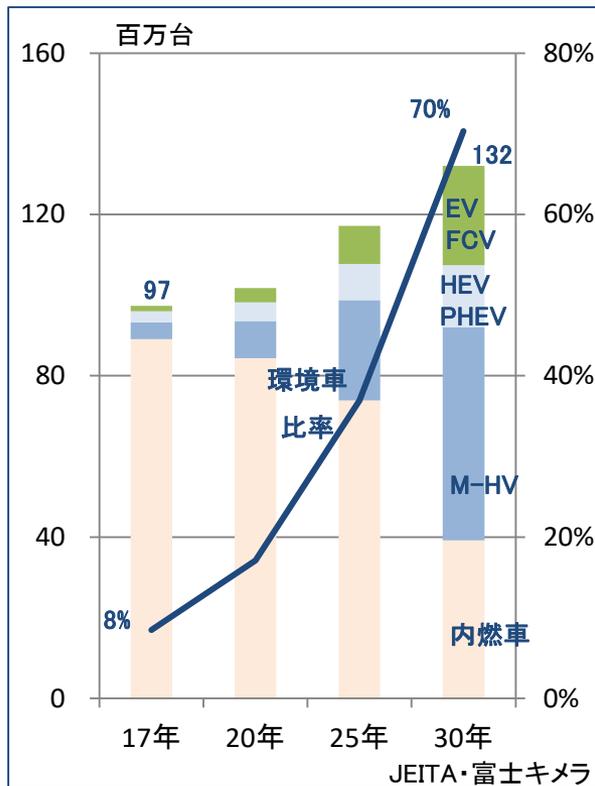
成長戦略

戦略市場の長期トレンドに変化は無い

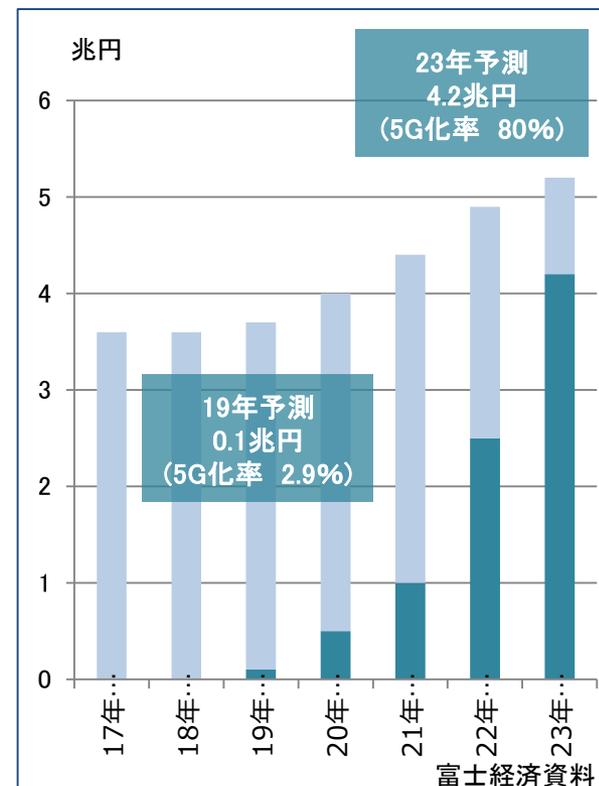
<エアコン市場>



<環境対応車世界生産台数>



<5G対応基地局世界市場>



- 白物家電 : INV(インバータ)化は中国や新興国を中心に今後も伸長
- 自動車 : 環境と電動化がキーワード、2030年には対応車両の割合が70%
- 通信 : 5Gは今後着実に普及拡大、2023年には4兆円を超える市場に拡大

■ 『開発改革』の推進

開発フロー	成長戦略に向けた施策	狙い
設計 コンセプト	SPPの定着 SanKen Power-electronics Platform	・デバイス:プラットフォーム開発 ・パワシス:モジュラー設計
プロセス 設計	Seoul Power Device Design Center	・最先端パワープロセス の早期開発
パッケージ 設計	Seoul Package Design Center	・次世代パッケージと必要 な要素技術の早期開発
プログラム 設計	Taiwan SanKen Design Center	・デジタル制御ICに必要な ファームウェア設計
製造ライン 設計	ものづくり開発センター	・グループ生産技術力の徹底強化 ・自動化やIoT/AIの推進
信頼性 評価	半導体信頼性評価センター	・信頼性評価スピードアップ ・効率化、機能強化

■ SPPの定着と効果

業務改革

- 開発効率35%向上

調達改革

- 部材共通化
材料コスト削減



設計・開発改革

- 技術のプラットフォーム化
要素・プロセス・パッケージ

生産改革

- 生産設備標準化
ライン構築時間△50%

■ 本社開発機能の再構築（新製品開発サイクルの短縮）

3つのセンターで開発のPDCAサイクルを加速する

- ①技術センター : 製品企画開発機能
- ②ものづくり開発センター : 新製品開発実現機能・プラットフォーム開発機能
- ③評価解析センター : 製品評価検査解析機能

競争力ある新製品の創出



ものづくり開発センターの設立

ものづくりに関わる人・技術を集約し、
開発サイクル1/2を目指す核となる

【竣工予定】 2021年3月

CASE 安全と環境への展開

安全

安全性向上
自動運転
ADAS Connected

パワーマネージメント(電源)IC

- ・ADAS、自動運転
- ・高性能ECU
- ・カメラ、各種センサ

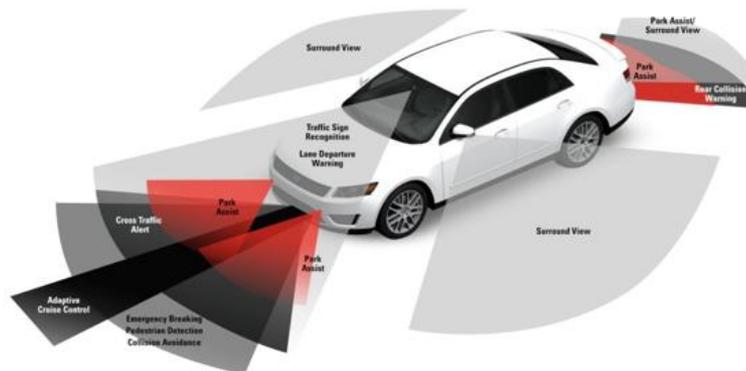
デジタル制御+アナログ制御
の最適融合でCASE対応

SPP共通技術(Platform)

- ✓ パワーデバイス
- ✓ パッケージ
- ✓ 制御システム

■新製品開発案件

● 環境/電動化 60% ● 従来用途 40%



パワーモジュール・IPM

車載モーター、OBC、DC/DC

- ・車載IPM
- ・パワーモジュール
- ・ディスクリット

低損失・高放熱化(高温動作)

環境車
&
電動化
【主機】
【補機】

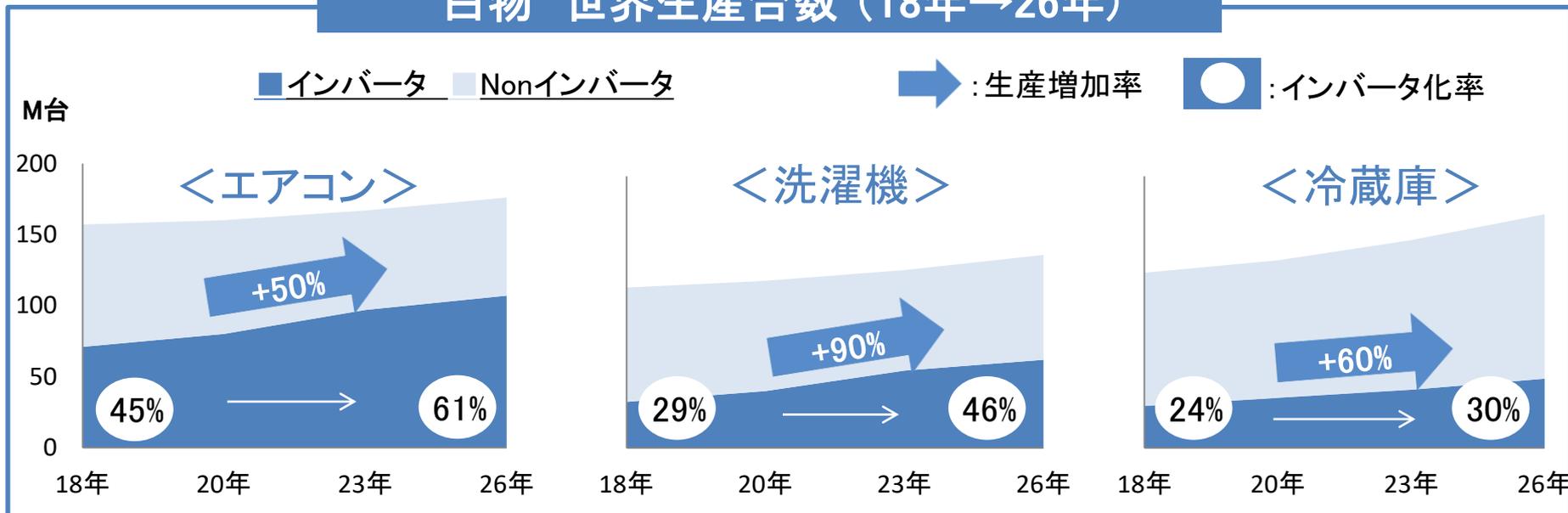
↓
高効率化

環境

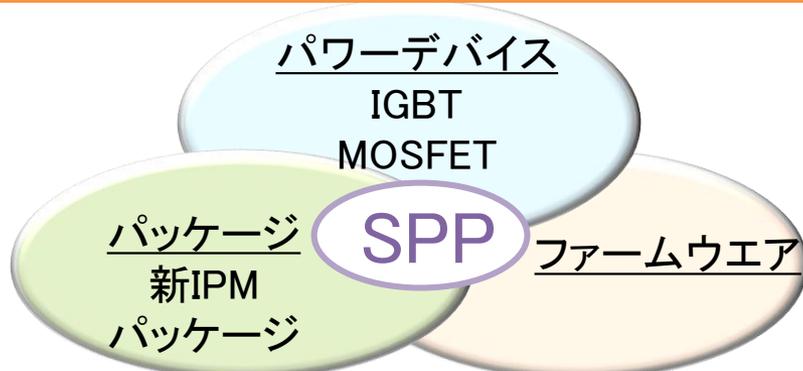
■ 白物市場

■ インバータ化、DCモータ化に最適なIPMを提供

白物 世界生産台数（18年→26年）



開発



次世代IPMの開発強化

- 制御内蔵・高機能化
- 低価格・低損失化
- 小型化・面実装化
- デジタル制御



■ 成長市場にリソースを集中

車載

- ・従来用途 (ICE・安全)
- ・環境対応車両
- ・ADAS

産機/民生

- ・再生可能エネルギー
- ・サーバーファン
- ・白物

■ 拡大地域

● 中国市場、北米市場

■ 車載 新製品開発案件

● 環境/電動化: 60%

● 従来用途: 40%

	用途	製品
低燃費 高効率	<ul style="list-style-type: none"> ・xEVパワートレイン ・冷却ファン ・電動クラッチ 	<ul style="list-style-type: none"> ・電流センサーIC
高信頼 高精度	<ul style="list-style-type: none"> ・パワーステアリング ・ブレーキ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ポジションセンサーIC ・モータコントロールIC
省エネ	<ul style="list-style-type: none"> ・モータ ・インバータ ・スマートホーム 	<ul style="list-style-type: none"> ・電流センサーIC ・モータコントロールIC

■ 拡大する市場向けの新製品早期開発と価格競争力の強化

世界の通信市場

4G

+

5G

23年基地局投資 4兆円

国内インフラ市場

国土強靱化緊急対策

電源への需要 350億円

海外インフラ市場

インドネシア現地2社と提携
蓄電機能付パワコン・UPS・ESS

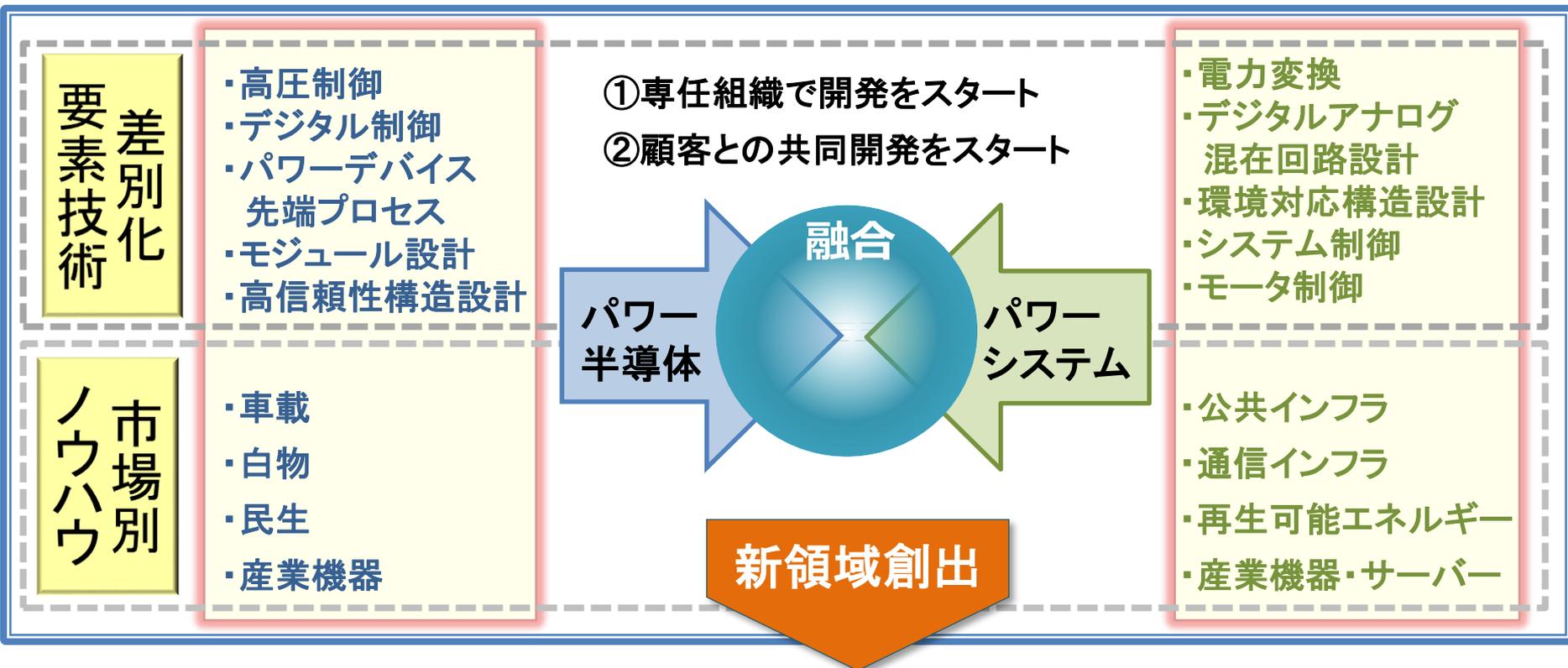
UPS市場のみで 200億円

開発 改革

- 本社(川越) ・SPPにおけるモジュラーデザインの導入
・開発スピードの向上と低コスト設計
・オーバースペックの解消

原価 低減

- SLJ(中国) ・国内大型電源用モジュールをローカル材料で低コスト生産
- SKO(日本) ・日本国内生産を求められる大型電源の組立・検査
低コストの組立・検査を目指した自動化ラインの構築
・SLJ生産モジュールのシステムへの組立・検査、品質保証
- SKI(インドネシア) ・海外向け量産品をローカル材料採用により低コスト生産

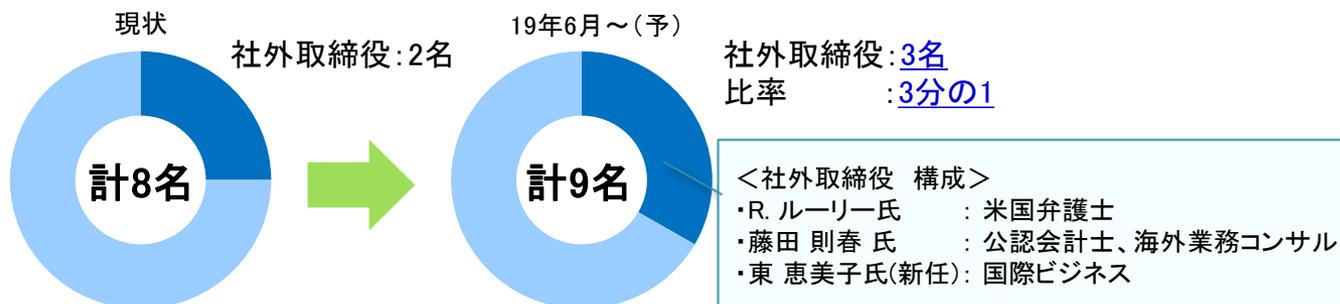


【融合エリア】	狙う効果	短期的目標	中期的目標
5G向け超小型基地局電源	小型軽量化 (装置→ボード→モジュール)	ローカル5G対応	ネットワーク供用対応
車を中心とした無線給電システム	小型、高効率、高性能化	小容量急速充電	中容量急速充電
IoTに対応する統合電源	多CH・分散電源を統合管理	環境対応された電源	電力ネットワーク対応電源
ロボットサーボモータ用電源システム	小型軽量、機電一体化	ドライバのモジュール化	インテリジェント化

コーポレート・ガバナンスの強化

取締役会構成

- 6月の株主総会にて女性の社外取締役1名を増員予定



- 取締役会のダイバーシティ(国際性、ジェンダー、スキル)を推進

指名委員会 (任意)

- 18年度に設置、19年度より本格的に運用開始
- 2019年6月 株主総会後の経営体制を審議
- 報酬委員会の評価をもとに、候補者の選解任を審議・答申

報酬委員会 (任意)

- 18年度に設置、2019年1月より新制度の運用開始
- 業績連動型報酬とし、基本報酬・短期・長期(株式)で構成
- 営業利益、ROEなどの業績に連動した評価指標を組み入れる

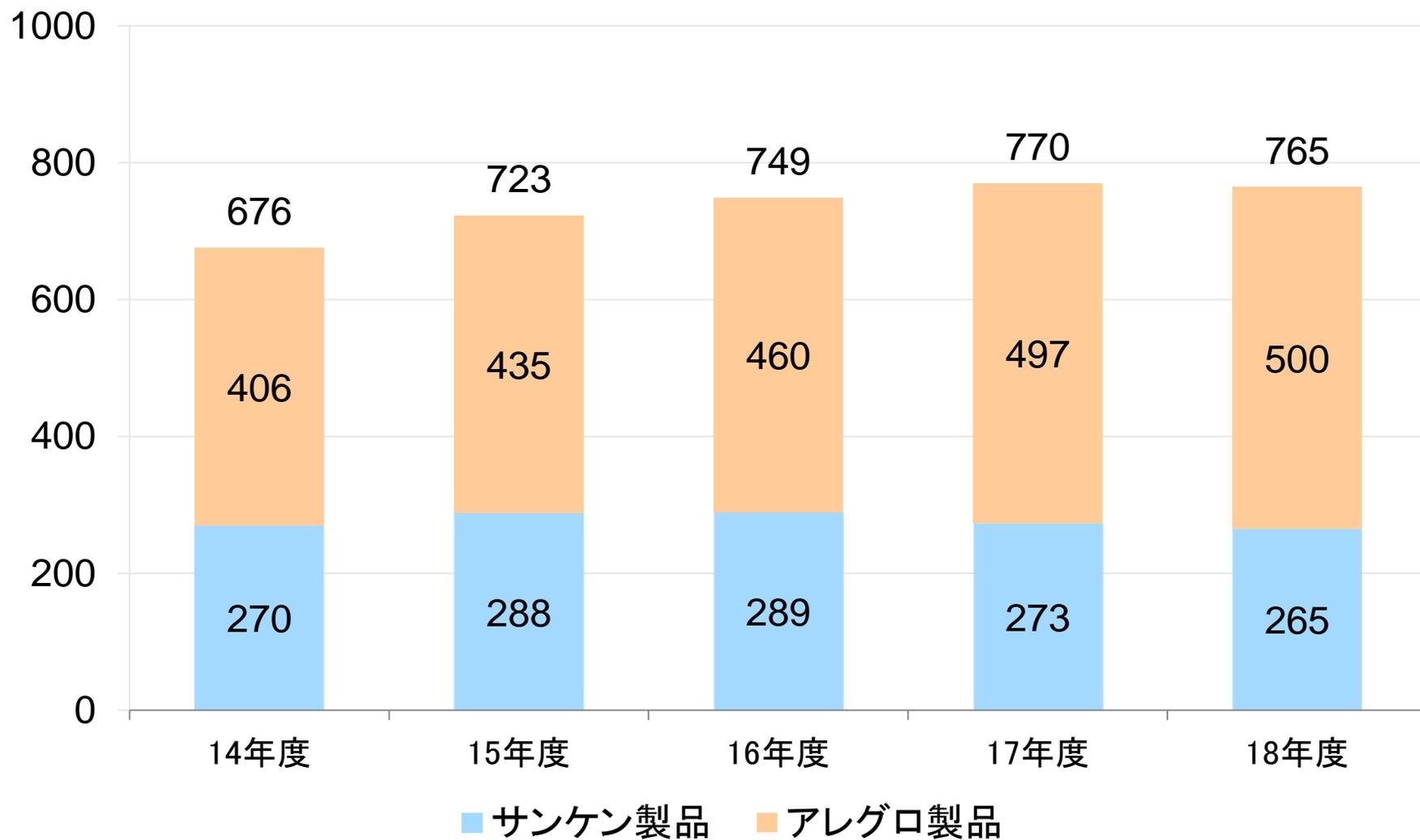
経営の透明性向上に向け、ガバナンス強化を図る



自動車向け半導体売上推移

(億円)

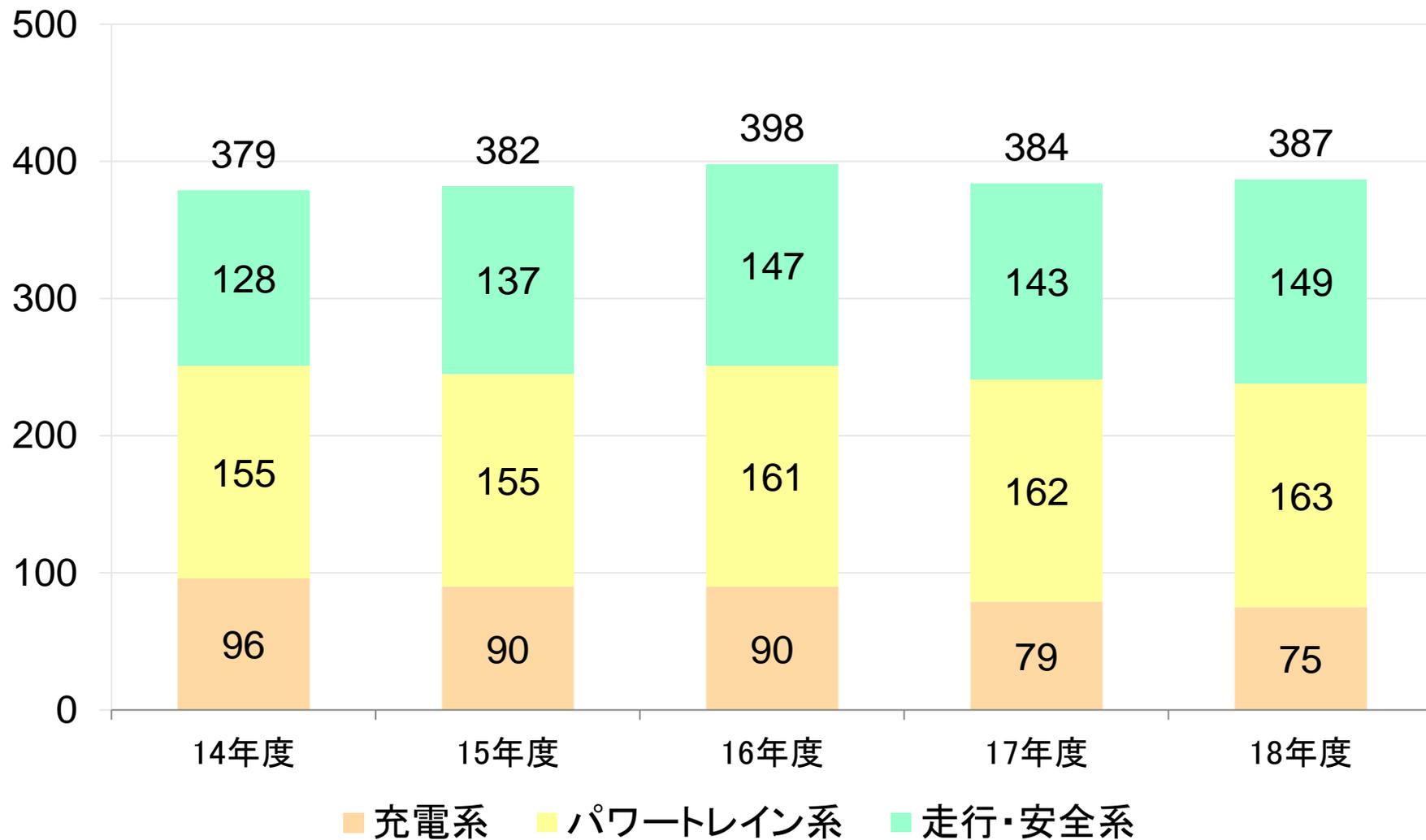
<連結ベース>



自動車向け半導体売上推移 <用途別>

(億円)

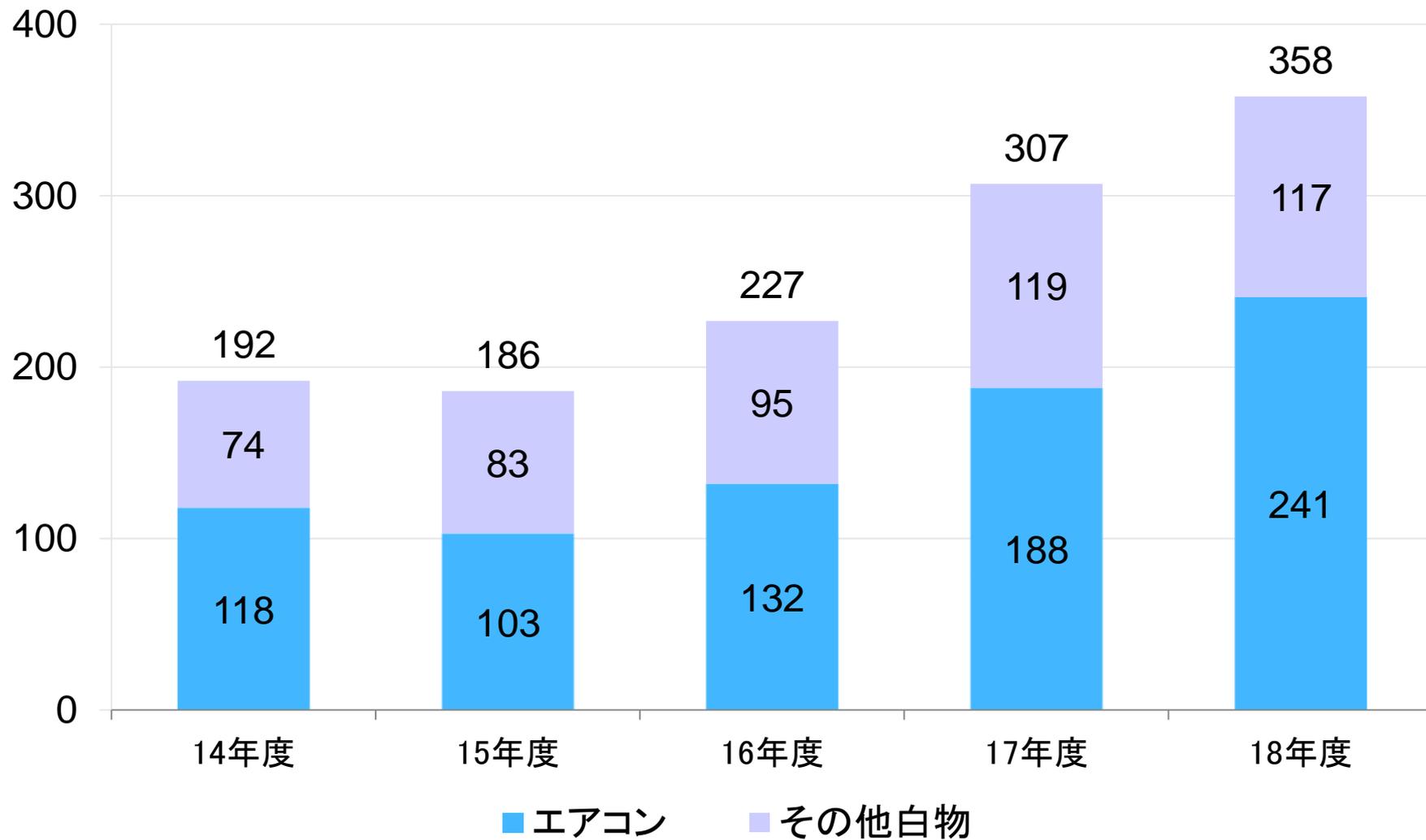
<単体ベース>



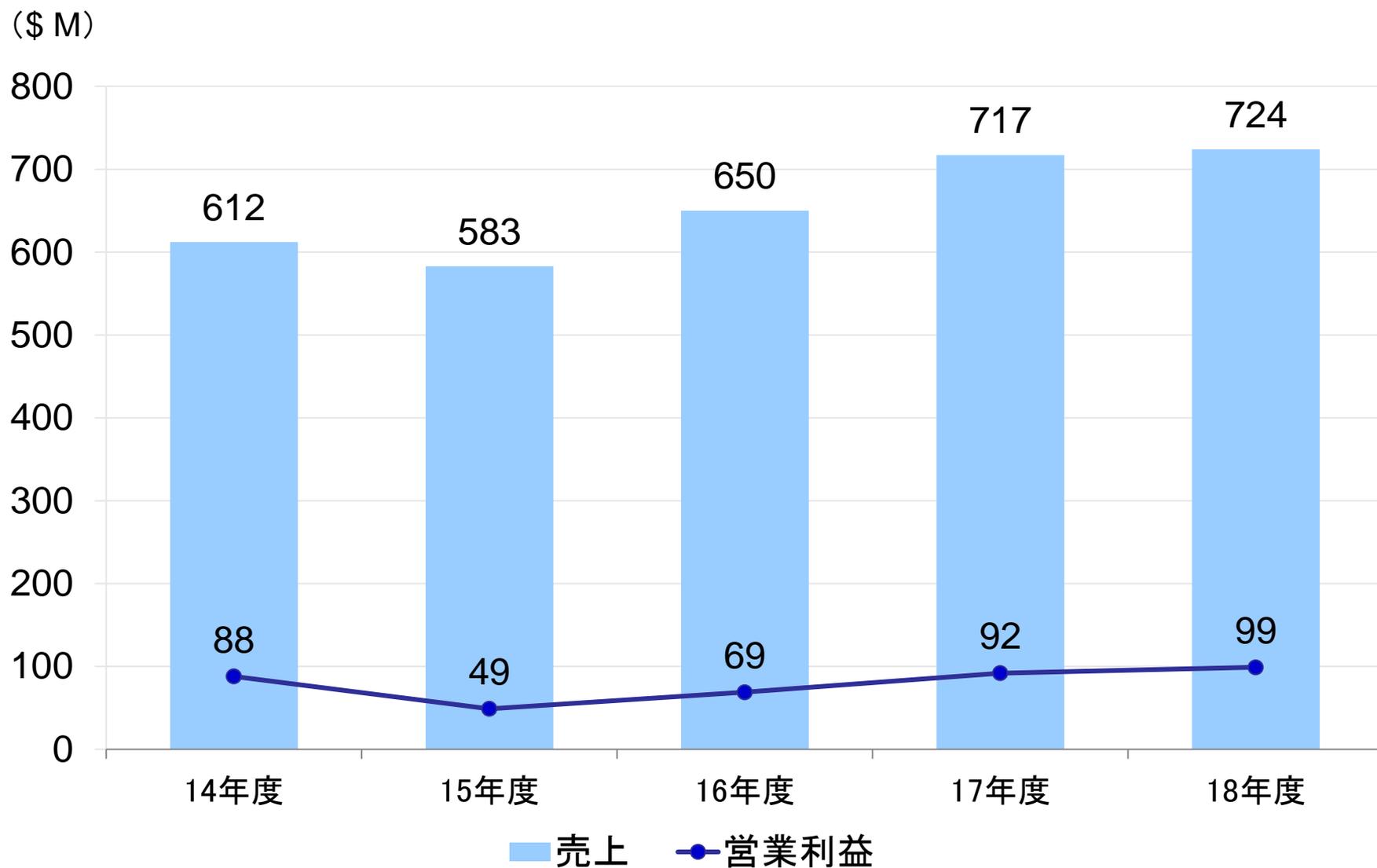
白物家電向け半導体売上推移

(億円)

＜単体ベース＞



AMI(アレグロ連結) 売上・営業利益推移



将来に関する記述についての注意事項

この資料に記載されている当社及び当社グループに関する業績見通し、計画、方針、戦略、目標、予定、判断、認識などのうち既に確定した事実でない記述は、将来に関する記述です。これら将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する前提を基礎として作成したものであり、既知または未知のリスク、不確実性、その他の要因を含んでいます。従って、実際の業績は、これらのリスク、不確実性、その他の要因により、業績見通しと大きく異なる可能性があります。また、当社は、適用法令の要件に服する場合を除き、業績見通しの見直しを含め、将来に関する記述を更新あるいは修正して公表する義務を負うものではありません。

当社が属するエレクトロニクス業界は、常に急激な変化に晒されていますが、当社の業績や財産に重大な影響を与えるリスク、不確実性、その他の要因には、(1) 経済環境、市場・需給動向、競争状態、(2) 為替レートの変動、(3) 技術進化への追従の成否、(4) 原材料の高騰あるいは調達難、(5) 各国・地域における法制度の変更あるいは社会情勢の急変、(6) 偶発事象の発生などがありますが、これらに限定されるものではありません。